

製品仕様書  
PRODUCT  
SPECIFICATION

---

*8072/8073*Series  
MULTI LINE MODULE CONNECTOR

京セラ株式会社  
KYOCERA Corporation

NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by
A	DCN22125	2022/03/07	T. Otani	H. Tamai	M. Yoshida
O	EDN-036	2001/01/18	K. Ohtaka		M. Sakaoka

1. 品名 MULTI LINE MODULE CONNECTOR

2. 形式 MULTI LINE MODULE CONNECTOR

3. 適用範囲 Scope

本仕様書は 8072/8073 シリーズコネクタの組立製品の仕様に適用する。

This specifies 8072/8073 Series MULTI MODULE CONNECTOR

4. 関連規格 Related documentation

・IEC 60512-1-100:2012 電子機器用コネクタ-試験及び測定- 第 1-100 部:一般-試験一覧

Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100:General-Applicable publications

・JIS C 5402-1-100:2014 電子機器用コネクタ-試験及び測定- 第 1-100 部:一般-試験一覧

Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100:General-Applicable publications

・JIS-C-5402:2014 電子機器用コネクタの試験法

Method for Test of Connectors for Electronic Equipment.

5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material

図面参照 Refer to drawings.

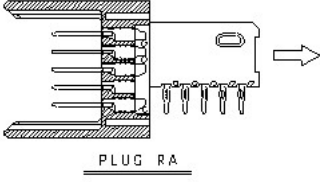
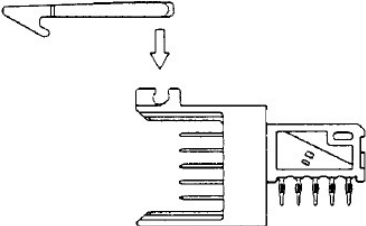
6. 製品型番 Part numbering

名称 DESCRIPTION	型番 PART NO	注記 NOTE
プラグ RA プレスフィットタイプ Plug RA PF Connector	17 8072 XXX 200 XXX	ラッチ取付けタイプ With Latch TYPE
リセプタクル ケーブルタイプ Receptacle Cable Connector	97 8073 XXX XXX XXX	
ラッチ Latch	81 8073 000 10X 007	

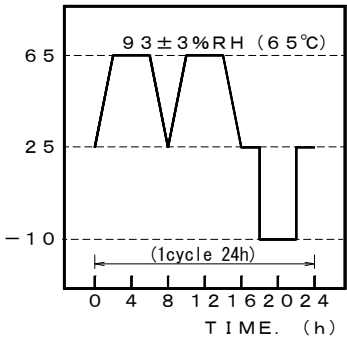
仕様 Spec

嵌合状態において、Under mating condition

		項目 Item	条件・方法 Condition	規格 Specification
7.一般 General	1	定格電流 Current rating		DC 0.7 A/contact (全シグナルコンタクト通電状態) (ALL SIGNAL CONTACTS LOADING)
	2	定格電圧 Voltage rating	—	DC 250 V/contact
	3	使用温度範囲 Operation environment	—	-55°C ~ 85 °C 低温に於いて氷結ないこと。 結露しないこと。 Humidity: 90 % MAX. Ice-free at the low temperature. No condensation shall occur.
	4	保存温度範囲 Storage environment	梱包状態にて While packed	-10°C ~ 60 °C 低温に於いて氷結ないこと。 結露しないこと。 Humidity: 90 % MAX. Ice-free at the low temperature. No condensation shall occur.
	5	適合基板厚 Applicable board thickness		t=1.4~4.8 mm
		*スルーホール仕様 APPLICATION THROUGH HOLE		
			銅スルーホール Copper through hole	はんだスルーホール (鉛フリー) SOLDER THROUGH HOLE (Pb-FREE)
		下穴径 Prepared hole DIA	φ 0.7 ±0.025	
		銅めっき厚 Copper plating thickness	25~50 μ m	
		はんだめっき厚 Solder plating thickness		7.6 μ m MIN.
		仕上径 Finished DIA	φ 0.6 ±0.05	φ 0.6 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.1</sub>
8.機械的 Mechanical	1	外観 Appearance	目視 Visual inspection	機能に有害なサビ、汚れ、キズ、 変形等のないこと。 No rust, contamination, damage or deformation harming functions.

2	<p>単一コンタクト抜去力 (初回抜去時) Individual Contact separation force</p>	<p>適合する規定のゲージ若しくは、プラグコンタクトを用いて行う。 Measurement shall be conducted with an applicable standard gage or an applicable plug contact</p>	<p>抜去力 Separation force 0.15 N MIN. (15 gf MIN.)</p>
3	<p>総合嵌合・離脱力 Total insertion force and separation force</p>	<p>毎分 100mm の速さで嵌合方向に挿入抜去を行い、その時の挿抜力を測定する。 A connector shall be inserted and separated at a speed of 100 mm/s</p>	<p>嵌合力 Insertion force 0.75 N x n MAX. (76 gf x n MAX.) 離脱力 Separation force 0.15 N x n MIN. (15 gf x n MIN.)</p>
4	<p>モジュール保持力 Module retention force</p>	<p>25 mm/min.</p>	<p>保持力 Retention force 9.8 N MIN. (1.0 kgf MIN.)</p>
			
5	<p>ラッチ挿入力 Latch insertion force</p>	<p>ラッチをコネクタに挿入する時の力を測定する。 The force to insert a latch to connector shall be measured.</p>	<p>挿入力 Insertion force 29.4 N MAX. (3.0 kgf MAX.)</p>
			
6	<p>プレスフィットポスト 基板挿入力 Press Fit post insertion force</p>	<p>7-5 項に規定された基板を使用し挿入力を測定する。 Insertion force shall be measured with the board specified in paragraph 7-5.</p>	<p>挿入力 Insertion force 156.8 N MAX. (16 kgf MAX.)</p>
7	<p>プレスフィットポスト 基板保持力 Press Fit post retention force</p>	<p>7-5 項に規定された基板を使用し保持力を測定する。 Retention force shall be measured with the board Specified in paragraph 7-5.</p>	<p>保持力 Retention force 9.8 N MIN. (1.0 kgf MIN.)</p>

	8	挿抜耐久性 Durability	無通電状態で 10 回/分 以下の速 さ without Current applied 10 times/min. N times	外観 Appearance 著しい腐食が生じないこと。 No evident corrosion. 接触抵抗 Contact resistance 5mΩ MAX													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>レベル LEVEL</th> <th>めっき仕様 PLATING</th> <th>挿抜回数(N) OPERATION(N)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>Pd/Ni 0.65 μm Au 0.76 μm</td> <td rowspan="2">500</td> </tr> <tr> <td>Pd/Ni 0.40 μm Au 0.03 μm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Au 0.38 μm</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Au 0.1 μm</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>			レベル LEVEL	めっき仕様 PLATING	挿抜回数(N) OPERATION(N)	1	Pd/Ni 0.65 μm Au 0.76 μm	500	Pd/Ni 0.40 μm Au 0.03 μm	2	Au 0.38 μm	250	3	Au 0.1 μm	50	
	レベル LEVEL	めっき仕様 PLATING	挿抜回数(N) OPERATION(N)														
1	Pd/Ni 0.65 μm Au 0.76 μm	500															
	Pd/Ni 0.40 μm Au 0.03 μm																
2	Au 0.38 μm	250															
3	Au 0.1 μm	50															
9	振動 Vibration	10~55~500 Hz/15 min /1.5mm (peak to peak) /DC 100 mA (3h per direction; XYZ, 9 h in total)/10G <b>IEC 60068-2-6:2007</b> <b>JIS C 60068-2-6:2010</b>	瞬断 Discontinuity 1 μs MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック 等ないこと。 No damage, loose part or crack. 接触抵抗 Contact Resistance 45 mΩ MAX.														
10	衝撃 Shock	50 G / 11 ms /DC 100 mA (3times per direction; XYZ) <b>IEC 60068-2-27:2014</b> <b>JIS C 60068-2-27:2014</b>	瞬断 Discontinuity 1 μs MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック 等ないこと。 No damage, loose part or crack.														
9.電氣的 Electrical	1	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	AC750 V、1 min (Leak 2 mA) <b>JIS C 5402-4-1:2005</b>	フラッシュオーバー、スパークオーバー、 絶縁破壊ないこと。 No Flashover, spark over dielectric breakdown.													
	2	絶縁抵抗 Insulation resistance	DC100 V、1 min <b>JIS C 5402-3-1:2005</b>	初期:Initial 10 <sup>4</sup> MΩ MIN. 試験後 After test 10 <sup>3</sup> MΩ MIN.													

	3	ローレベル接触抵抗 Low level contact resistance	四端子法にて Four prove method <b>JIS C 5402-2-2:2005</b>	初期:Initial: 40 mΩ MAX. 試験後:45 mΩ MAX.															
	4	温度上昇 Temperature rise	嵌合状態でコンタクトを直列に結線 Under mating condition, all contacts shall be connected serially. <b>JIS C 5402-5-1:2005</b>	定格電流にて 30 K MAX. at the Current rating															
10.耐環境 Environment	1	二酸化硫黄 SO <sub>2</sub>	40±2 °C / 75% / 10±1 ppm / 96 h <b>IEC 60068-2-42:1982</b> <b>JIS C 60068-2-42:1993</b>	接触抵抗 Contact Resistance 45 mΩ MAX.															
	2	温度サイクル Temperature cycling	5 cycles <b>(Modified) IEC 60068-2-14:2009</b> <b>JIS C 60068-2-14:2011</b>	接触抵抗 Contact Resistance 45 mΩ MAX.															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>段階 Step</th> <th>温度(°C) Temperature</th> <th>時間(分) Time(min.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-55±3</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25 <sup>+10</sup>/<sub>-5</sub></td> <td>5 MAX.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>85±2</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>25 <sup>+10</sup>/<sub>-5</sub></td> <td>5 MAX.</td> </tr> </tbody> </table>		段階 Step	温度(°C) Temperature	時間(分) Time(min.)	1	-55±3	30	2	25 <sup>+10</sup> / <sub>-5</sub>	5 MAX.	3	85±2	30	4	25 <sup>+10</sup> / <sub>-5</sub>	5 MAX.
			段階 Step		温度(°C) Temperature	時間(分) Time(min.)													
1			-55±3		30														
2			25 <sup>+10</sup> / <sub>-5</sub>		5 MAX.														
3	85±2	30																	
4	25 <sup>+10</sup> / <sub>-5</sub>	5 MAX.																	
	3	温湿度サイクル Temperature and humidity cycling	10 Cycle / 65°C / 93±3% <b>IEC 60068-2-38:2009</b> <b>JIS C 60068-2-38:2013</b> 	接触抵抗 Contact Resistance 45 mΩ MAX. 絶縁抵抗 Insulation resistance 10 <sup>3</sup> MΩ MIN. 耐電圧 Dielectric withstanding voltage フラッシュオーバー、スパークオーバー絶縁破壊ないこと。 No Flashover, spark over, dielectric breakdown															
	4	高温加速(寿命) High temperature(Life)	85±2 °C / 96 h <b>IEC 60068-2-2:2007</b> <b>JIS C 60068-2-2:2010</b>	接触抵抗 Contact Resistance 45 mΩ MAX.															

## 特記事項 Special Instructions

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

- (1) 本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2) 本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。

If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive products, or replace or repair defective products.

- (3) 以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の条件が加わった事が証明された場合。

If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to you.

2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

## 有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛 Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any unclarity arises in this specification.